

光碟內容說明

在 DMA-6410XP 教學平台的產品光碟中包含了許多實用的東西，讀者可以從產品光碟的 README 文件瞭解光碟的內容，主要包含以下的內容：

上層目錄	說明
User Manual	平台的操作手冊 PDF 檔。
SCH	平台的電路圖，以 PDF 格式的檔案提供。
Datasheet	平台所採用電子元件的 Datasheet 文件。
RVDS-AP	ARM RealView Development Suite (RVDS)的實驗範例。
WinCE 6.0	包含以下子目錄： <ol style="list-style-type: none">1. BSP。2. Sample Image：在這個目錄應放置 EBOOT.bin、EBOOT.nb0、STEPLDR.bin、NK.bin 等映像檔。3. DEMO AP：應用程式或 DEMO 程式的可執行檔，包含部分有開放的程式碼。4. Lab Source：(書籍)上層實驗應用的程式碼。5. SDK：DEMO AP 及實驗程式所使用的 SDK。6. 硬體編解碼 Demo 的 Source，具體內容見第十章 10-2.2.6 的“MFC(硬解碼)”模式
Linux	包含以下子目錄： <ol style="list-style-type: none">1. Cross compiler。2. U-boot。3. Kernel。4. Filesystem。5. Sample Image：在這個目錄內應放置 u-boot.bin、zImage 及 root_dma.cramfs 等映像檔。因應 U-boot 裡的 run rootfs 指令，請註明 root_dma.cramfs 是對應到 Filesystem 目錄裡的那一個根檔案系統。6. Driver：驅動程式的程式碼。7. TEST：測試或 DEMO 程式，包含程式碼。

<p>Android</p>	<p>包含以下子目錄：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cross compiler。 2. U-boot。 3. U-Boot_MMC：支援由 SD 卡啟動的 U-Boot 版本。 4. Kernel。 5. Android：Android 的程式碼，包含編譯 Android 的腳本文件等。 6. Sample Image：在這個目錄內應放置 u-boot.bin、zImage、ramdisk-uboot.img、system.img 及 userdata.img 等映像檔。 7. NDK：包含 Android NDK、cygwin 及一個 LED 控制的實驗範例。 8. Lab：包含以下項目 <ol style="list-style-type: none"> (1) 驅動程式的程式碼。 (2) libXXX.so 的程式碼及二進位檔案。 (3) 以 Android 1.6 SDK 開發的實驗程式碼等。
<p>Tools</p>	<p>包含以下項目：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 微軟公司的 ActiveSync 4.5 及 USB 驅動程式。 2. ConvertZ：這是繁簡中文轉換的工具。 3. 串列終端工具 DNW 及 USB 驅動程式。 4. TFTPD32：TFTP 伺服器的 Windows 版。 5. IROM_Fusing_Tool：製作啟動用 SD 卡的工具程式。 6. DMATEK Com Debugger：長高科技版的串列工具程式。